

今回は、電子部品などの価格高騰についてお伝えします。高騰の主要因は、**AIの急速な普及とデータセンターの増加**です。

メモリ価格

2026年現在、メモリー価格は記録的な高騰局面にあり、特に第1四半期の契約価格は前期比で最大約2倍に達しています。背景には、AIやデータセンター向け需要の急拡大があります。

1. DRAM (主記憶メモリー)

DRAM市場は極端な価格上昇局面にあり、あらゆるセグメントで供給不足が深刻化しています。

PC向けDRAM : 2026年第1四半期の契約価格は、前期比で100%以上の上昇が見込まれています。

サーバー向けDRAM : 北米の大手クラウドサービスプロバイダによる争奪戦により、価格は前期比で約90%上昇しています。

モバイル向けDRAM : こちらも前期比で約90%の大幅な価格上昇が予測されています。

2. NAND Flash (ストレージ)

NAND FlashもDRAMに追隨して高騰しています。

全般的な価格上昇 : 2026年第1四半期の契約価格は、前期比で55~60%の上昇が見込まれています。

エンタープライズSSD : データセンター向けSSDの価格は、前期比で53~58%の上昇が予測されています。

3. HBM (高帯域幅メモリー)

AIサーバーに不可欠なHBMメモリーは、特に深刻な状況です。

供給不足 : SKハイニックスやサムスン電子などは、2026年分の生産枠分が既に予約で埋まっている状態のようです。

価格高騰 : 極端な供給不足により、スポット市場価格は前年比で2.5倍から3倍に跳ね上がっていると報告されています。

今後も主要メーカーは利益を重視し、AI向け製品に生産を集中させる方針のため、汎用品の供給は引き続き制限される見通しです。この売り手優位の状況は長期化が予想され、専門家は価格高騰が2028年以降まで続く可能性を指摘しています。

受動部品やコネクタ価格

2026年の受動部品(コンデンサ、抵抗器、インダクタなど)やコネクタの価格・市場動向は、AI、自動車、通信インフラ向け需要の拡大を背景に、総じて堅調もしくは横ばいから緩やかな上昇基調で推移すると見込まれています。

1. 受動部品の価格推移と市場見通し

市場全体 : 2026年の受動部品市場は拡大を見込んでおり、年平均成長率は5~6%台で推移すると予測されています。

価格動向 : 前年に引き続き、AIサーバー、データセンター、EV、IoT機器向けの需要が非常に堅調です。特に高性能・小型・耐熱・高信頼性が求められる分野では供給が需要に追いつかず、価格は高水準を維持するか、緩やかに上昇していくと予想されます。

2. コネクタの価格推移と市場見通し

市場全体 : コネクタ市場は非常に堅調で、2026年には前年比で約5~7%程度の成長が見込まれています。

価格動向 : AIデータセンター向けの高密度・高速伝送コネクタや、自動車の電装化に伴う高圧・大電流コネクタの需要が急増しており、これらハイエンド製品の価格は上昇傾向にあります。

価格変動の要因

電子部品の価格変動の要因として以下のことが考えられます。

AIと高速通信 : AIサーバーやデータセンター向けの需要が電子部品全体の価格を下支えする要因となっています。

自動車のEV化 : 車載用部品の信頼性向上要求と供給制限が価格下支え要因です。

原材料とエネルギーコスト : 銅や貴金属(パラジウム等)の原材料価格や、人件費・エネルギーコストの変動が、製造コストに転嫁される可能性があります。

その他(銅、アルミ、PCの価格)

- AI技術の急速な普及に伴う電力需要の増加により、配線材料としての銅や、その代替としてのアルミの価格も高騰しています。
- PC価格も上昇傾向が続く見込みです。AI需要の拡大によるメモリー・SSD不足、円安、物流費や人件費の増加が主な要因で、年内に価格が下がる可能性は低い状況です。特に4月以降は5~20%の値上げも懸念されています。短期間での改善は期待しにくいいため、必要な場合は早めの対応が重要です。